

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

公告编号：2026-026

# 苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 436,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	珂玛科技	股票代码	301611
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	仇劲松	雷梦思	
办公地址	江苏省苏州市高新区新钱路 1 号	江苏省苏州市高新区新钱路 1 号	
传真	0512-66918281	0512-66918281	
电话	0512-68088521	0512-68088521	
电子信箱	jerry.qiu@kematek.com	m.lei@kematek.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (1) 公司所处行业情况：

全球半导体市场规模和半导体制造设备支出显示出强劲的增长态势，主要是由于 AI、云基础设施、先进消费电子产品等领域的持续需求所带动。根据 WSTS 数据，2025 年全球半导体市场规模持续攀升，全年全球半导体市场规模将达到 7,009 亿美元，同比增长 11.2%；2026 年的全球半导体市场规模预计将进一步上升 8.5%至 7,607 亿美元。根据 SEMI 数据，2024 年全球半导体制造设备销售总额达 1,170 亿美元历史纪录，同比增加 10%，创下历史新高；2025 年、2026 年预计将延续上升势头，分别达 1,215 亿美元、1,394 亿美元，分别同比增加 4%、19%。全球半导体行业预计将在 2025 年启动 18 个新晶圆厂建设项目，其中包括 3 座 8 英寸和 15 座 12 英寸新晶圆厂，大部分预计将于 2026 年至 2027 年开始运营。这一扩产趋势也得到了 Knometa Research 追踪数据的印证，其指出 2025 年全球将有 17 条新晶圆产线实质性投入运营，涵盖了逻辑代工、存储和模拟芯片等多个关键领域，推动全球晶圆产能创下历史新高。

中国大陆仍然稳居全球半导体设备支出龙头。根据 SEMI 数据，2025 年中国大陆半导体设备支出总值约 493 亿美元，中国大陆预计在 2025 年新启动 3 座晶圆厂建设项目。根据芯谋研究数据，受供应链自主可控需求驱动，国产替代进程大幅加速，中国半导体设备国产化率在 2025 年已攀升至 35%，全面进入核心加速期。半导体设备在成熟制程领域国产化已取得显著进展，但先进制程领域的高端设备仍需突破“卡脖子”环节，未来国产替代空间广阔。在我国大力扶持半导体产业的背景下，全球半导体及上游零部件全产业链产能向中国大陆转移，在国产化背景趋势下，预计未来中国大陆半导体领域市场需求在阶段性波动恢复后将继续保持平稳较快增长。

从国际层面来看，全球半导体设备先进结构陶瓷市场继续保持增长态势，来自日本、美国、韩国和欧洲的供应商在不同细分市场和技术领域保持领先地位，尤其在半导体设备关键部件“功能-结构”模块类产品方面，例如陶瓷加热器、静电卡盘以及超高纯碳化硅套件等，通常为全球半导体设备厂商和晶圆厂商的首选供应商，包括国内半导体设备厂商和晶圆厂商。

### (2) 公司主要产品及服务：

#### (a) 先进陶瓷材料零部件：

公司先进陶瓷业务的基础是材料，产品形式是高度定制化的零部件，最终端应用于半导体、新能源等多个国民经济重要行业。公司掌握了从材料配方到零部件制造的先进陶瓷全工艺流程技术，目前已量产氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钽和氧化钛 6 大类材料先进陶瓷材料，累计设计开发了一万余款定制化零部件。

公司先进陶瓷材料零部件应用于多个领域，按领域区分的产品情况如下：

(i) 半导体领域

半导体设备零部件是公司报告期内先进陶瓷产品的最主要应用。半导体设备是半导体产业的基础支撑，其中前道工艺主要完成晶圆制造，该等工艺设备类型繁杂，技术难度较高。半导体设备由腔室内和腔室外组成，陶瓷大部分用在更接近晶圆的腔室内，其技术要求严苛，须在先进陶瓷材料性能、硬脆难加工材料精密加工及新品表面处理等方面满足客户要求。

公司先进陶瓷主要应用于晶圆制造前道工艺设备，目前已进入刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻和氧化扩散等多种设备，是国内半导体设备用先进陶瓷材料零部件的头部企业。


公司用于半导体设备的先进陶瓷材料零部件产品主要应用于腔室内，其中部分零部件直接与晶圆接触，是集成电路制造中关键的精密零部件，包括圆环圆筒、气流导向、承重固定和手爪垫片等结构件产品，以及陶瓷加热器、静电卡盘以及超高纯碳化硅套件等高难度“功能-结构”一体模块化产品。

分不同工艺流程及对应半导体设备，公司先进陶瓷材料零部件产品的应用情况如下：

工艺流程		刻蚀	薄膜沉积	离子注入	光刻及相关的涂胶显影	氧化/扩散、退火、合金等	
应用公司产品的前道设备		刻蚀机	PVD、CVD 和 ALD 设备	离子注入设备	光刻机、涂胶显影设备	氧化扩散设备	
设备图示							
公司产品	结构件类产品	产品类型	圆环圆筒类、气流导向类、承重固定类、手爪垫片类、真空吸盘	圆环圆筒类、气流导向类、承重固定类、手爪垫片类	圆环圆筒类、承重固定类、手爪垫片类	承重固定类、手爪垫片类	
		材料类型	氧化铝、氮化铝、碳化硅	氧化铝、氮化铝、碳化硅	氧化铝、氮化铝	氧化铝、碳化硅	氧化铝、氮化铝、碳化硅
	“功能-结构”一体模块化产品	产品类型	静电卡盘	陶瓷加热器、静电卡盘	-	-	陶瓷加热器、超高纯碳化硅套件
		材料类型	氧化铝	氧化铝、氮化铝	-	-	氮化铝、碳化硅

公司在半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氮化铝零部件等“卡脖子”产品方面实现了国产替代，多项关键技术指标达到国内领先、国际主流水平。同时，公司亦是目前国内少数有多种陶瓷材料和产品通过国际头部半导体设备厂商 A 公司认证且被其批量采购的先进结构陶瓷企业之一。

此外，公司从 2016 年承接国家“02 专项”课题起，不断完善核心材料配方并攻克了多项复杂工艺，是国内较早切入“功能-结构”一体模块化产品研发、客户验证并批量生产的企业。公司目前主要“功能-结构”一体模块化产品研发和产业化进展如下：

产品名称	产品应用设备图	产品图示	适用半导体设备	功能	全球主要供应商	产业化进展		
						客户拓展	累计出货量	累计开发款式
陶瓷加热器			薄膜沉积设备（具体包括 CVD、PVD、ALD 设备）、激光退火设备	薄膜沉积工艺过程中，均匀加热硅片，使构造稳定的沉积工艺环境，对晶圆质量和制造良率起关键作用	日本碍子全球份额超过 50%	(1) 供应北方华创、中微公司、拓荆科技、O 公司、P 公司和华卓精科等； (2) 在 Q 公司生产中大批量应用	截至 2025 年 12 月末，已累计生产并交付超过 1,800 支	6 英寸、8 英寸各已开发 2 款产品，12 英寸已开发 40 款产品
静电卡盘			刻蚀机、部分薄膜沉积设备	通过静电吸附硅片，并吸引等离子体完成刻蚀工艺。在 PVD 设备中往往与陶瓷加热器搭配使用	日本特殊陶业是全球第一大供应商，其他供应商包括京瓷集团等	(1) 8 英寸刻蚀机 Monopolar 静电卡盘已经通过 B 公司验证并小规模量产； (2) 12 英寸 ICP/CCP 刻蚀机 Monopolar 静电卡盘已通过 B 公司验证并小规模量产，多区加热静电卡盘已交付测试	截至 2025 年 12 月末，已小批量出货	8 英寸和 12 英寸静电卡盘已完成验证并实现小规模量产，12 寸多区加热静电卡盘已完成产品开发
超高纯碳化硅套件			氧化扩散设备	将热源均匀、稳定地传导至晶圆，提供高纯度、稳定的高温环境	CoorsTek 是全球第一大供应商，市场份额超过 80%，日本旭硝子全球份额为 10~20%	(1) 6 英寸非渗硅套件通过北方华创及 Fab 端验证并取得多套批量订单； (2) 8 英寸非渗硅套件通过北方华创验证，正在 Fab 端推广； (3) 12 英寸渗硅套件部分部件，例如 Cap、隔热片等已通过北方华创验证，其他部件例如晶舟等尚在验证中	截至 2025 年 12 月末，已小批量出货	6 英寸已开发 1 款全套产品，8 英寸已开发 2 款全套产品，12 英寸全套中部分部件已验证通过并少量生产，部分正在开发验证中

(ii) 泛半导体领域

在显示面板制造、LED 制造及光伏制造等方面，公司已量产用于刻蚀、PVD、CVD 设备和工艺连接器等的先进陶瓷材料零部件。

(iii) 其他领域

在电子（包括锂电池）材料粉体粉碎和分级领域，公司主要生产砂磨机涡轮、分级机分级轮、三辊机轧辊等先进陶瓷材料零部件，凭借高硬度、高韧性特点，它们被使用在多种粉体粉碎和分级设备上，作为核心零部件，发挥研磨、击碎、摩擦、分离和筛选等关键功能。公司作为国内本土企业的代表实现了关键零部件如“分级轮”的国产化，“分级轮”产品的最大运转线速度超过 60m/s，分级粒度可达到 1  $\mu$  m，上述两项关键性能指标均已达到全球主流水平。

此外，在汽车制造领域，公司主要生产氧化锆、氧化铝材质的焊装销和定位销等产品，焊装销被用在中高端汽车的生产焊接设备，起到高温、火花保护等功能，定位销被用在汽车的装配过程中，起到定位的功能；在纺织领域，公司针对不同纱线类型调整材料配方并设计晶粒规格，改变先进陶瓷表面粗糙度等表面结构，发挥引导及保护纱线的功能；在生物医药领域，生物医药中药剂注射、灌装等工序设备对零部件的耐腐蚀性要求高，公司已生产并销售用于高压均质机的陶瓷棒、隔离套等生物医药设备零部件产品。

**(b) 表面处理服务：**

公司表面处理服务面向显示面板制造厂和设备制造原厂，主要为显示面板工艺设备零部件提供清洗和再生改造服务。通过精密清洗、阳极氧化和熔射等主要手段，以洗净再生、熔射再生等综合解决方案为先进陶瓷、石英、金属等多种类型的设备零部件进行阶段性污染物控制，提高部件耐腐蚀性等性能，以保障显示面板制造工艺稳定、提高大规模制造良率。公司服务于多家全球知名显示面板制造企业，具备较强的综合服务能力，在表面处理的洁净度、耐用性等关键指标上客户反馈良好，赢得了较高的市场声誉。

表面处理还是先进陶瓷材料零部件新品制造的重要后道工序之一。公司采用精密清洗严格量化控制表面颗粒物、金属离子等污染物，并采用喷砂和熔射等形成特定表面涂层和形貌。这些特殊工艺能力也属于陶瓷产品生产的核心技术。

**(3) 公司主营业务增长的驱动因素：**

公司主营业务收入主要为先进陶瓷材料零部件销售收入、其他材料零部件销售收入以及泛半导体设备表面处理服务收入，收入规模逐年增长，合计占营业收入的比例在 99%以上，公司主营业务突出。其他业务收入主要为零部件加工服务收入及贸易业务收入等，占营业收入的比重较小。

**(a) 先进陶瓷材料零部件：**

公司在 2025 年度及 2024 年度先进陶瓷材料零部件的营业收入分别为 97,321.91 万元和 76,819.56 万元，2025 年比去年同期增长 26.68%。

先进陶瓷材料零部件的下游主要应用领域包括半导体、泛半导体、粉体粉碎和分级等领域，各领域收入规模及占比情况具体如下：

单位：人民币万元

应用领域	产品	2025 年度		2024 年度	
		金额	占比	金额	占比
半导体领域	结构件产品	55,253.98	56.78%	40,111.89	52.22%
	“功能-结构”一体模块化产品	32,330.67	33.22%	29,077.07	37.85%
泛半导体领域		3,410.52	3.50%	3,216.68	4.19%
粉体粉碎和分级领域		3,227.61	3.32%	3,181.33	4.14%
其他领域		3,090.13	3.18%	1,232.59	1.60%
<b>合计</b>		<b>97,312.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>76,819.56</b>	<b>100.00%</b>

半导体领域是公司产品的主要应用方向，公司在 2025 年度及 2024 年度来自半导体设备领域的先进陶瓷材料零部件收入分别为 87,584.45 万元和 69,188.96 万元，占先进陶瓷材料零部件收入的比例分别为 90.00%和 90.07%，2025 年比去年同期增长 26.58%。

2025 年度，得益于中国半导体市场持续扩张，中国半导体产业规模的快速增长以及设备国产替代程度不断提高，下游半导体领域客户采购需求快速增长，公司订单饱满，带动了公司先进陶瓷材料结构件产品在半导体领域销售收入规模的增长。半导体领域结构件产品，2025 年销售收入比去年同期增长 37.75%。

2025 年，半导体设备领域收入的增加也来源于公司“功能-结构”一体模块化产品的持续大规模量产交付。基于多年技术积累、研发及产业化布局，公司半导体设备核心部件陶瓷加热器实现国产替代，该“功能-结构”一体模块化产品解决了半导体晶圆厂商 CVD 设备关键零部件的“卡脖子”问题。公司为半导体晶圆厂商和国内半导体设备厂商研发生产并销售多款陶瓷加热器产品，装配于 SACVD、PECVD、LPCVD 和激光退火等设备，部分陶瓷加热器产品已量产并大量应用于晶圆的薄膜沉积生产工艺流程。公司在 2025 年继续着力于陶瓷加热器的性能优化及产品迭代，借助先进生产基地项目在 2025 年初投产的优势，优化工艺流程，持续推动产品向客户的稳定交付。同时，静电卡盘与超高纯碳化硅套件也逐步完成验证并开始小批量交付，形成了一定的收入。半导体领域“功能-结构”一体模块化产品，2025 年销售收入比去年同期增长 11.19%。

2025 年，受国内消费电子行业温和复苏的影响，公司来自显示面板、LED 和光伏等其他泛半导体的结构件产品的收入小幅增长；国内新能源相关领域已度过产能相对过剩的阵痛期，整体行业保持稳定，故公司粉体粉碎和分级领域收入在 2025 年度基本保持平稳。

公司先进陶瓷材料零部件应用的其他领域包括能源环保、汽车生产、纺织和生物医药等领域。

**(b) 表面处理服务：**

公司表面处理服务包括熔射再生服务和洗净再生服务，下游均面向泛半导体领域，在 2025 年度及 2024 年度收入分别为 8,137.15 万元和 8,204.90 万元，基本保持了稳定。公司表面处理服务收入具体构成如下：

单位：人民币万元

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	占比	金额	占比
熔射再生业务	5,852.68	71.93%	5,511.06	67.17%
洗净再生业务	2,284.47	28.07%	2,693.84	32.83%
合计	8,137.15	100.00%	8,204.90	100.00%

2025 年度公司表面处理业务收入规模基本维持稳定。

**(c) 其他材料零部件：**

公司在 2025 年度及 2024 年度其他材料零部件产品收入分别为 1,225.62 万元和 328.92 万元，呈增长趋势。其他材料零部件主要包括金属零部件、石墨零部件和 CVD 碳化硅涂层零部件，其中金属零部件主要产品包括上部电极、壁板等，主要用于显示面板生产设备；石墨零部件和 CVD 碳化硅涂层零部件系苏州铠欣的原有业务，2025 年 7 月公司完成对苏州铠欣的收购后，石墨零部件和 CVD 碳化硅涂层零部件的销售收入助力了其他材料零部件的收入规模的增长。

**3、主要会计数据和财务指标****(1) 近三年主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	2,613,142,474.85	1,967,300,323.94	32.83%	1,349,787,769.82
归属于上市公司股东的净资产	1,776,824,889.80	1,519,409,818.81	16.94%	736,477,633.70
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	1,073,398,286.26	857,381,991.35	25.19%	480,449,554.09
归属于上市公司股东的净利润	289,087,559.51	310,974,768.28	-7.04%	81,860,699.47
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	288,001,958.31	305,752,913.25	-5.81%	77,688,779.54
经营活动产生的现金流量净额	238,988,809.31	229,901,208.58	3.95%	46,586,832.10
基本每股收益（元/股）	0.66	0.81	-18.52%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.81	-18.52%	0.23
加权平均净资产收益率	17.31%	29.32%	-12.01%	11.86%

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,892,688.65	272,504,895.75	273,541,457.02	279,459,244.84
归属于上市公司股东的净利润	87,092,902.76	84,770,990.62	72,656,425.02	44,567,241.11
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	86,064,692.58	84,482,796.24	72,966,737.95	44,487,731.54
经营活动产生的现金流量净额	66,929,232.16	74,230,380.13	41,350,611.16	56,478,585.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	22,612	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	21,929	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0	持有特别表决 权股份的股东 总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称		股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况			
						股份状态	数量		
刘先兵		境内自然人	44.19%	192,649,465.00	192,649,465.00	不适用	0.00		
胡文		境内自然人	16.67%	72,676,450.00	72,676,450.00	不适用	0.00		
苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）		境内非国有法人	3.65%	15,925,314.00	15,925,314.00	不适用	0.00		
苏州市博臻企业管理咨询中心（有限合伙）		境内非国有法人	1.41%	6,126,729.00	6,126,729.00	不适用	0.00		
刘俊		境内自然人	1.35%	5,872,997.00	0.00	不适用	0.00		
北京诺华资本投资管理有限公司—北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）		其他	0.92%	4,009,575.00	0.00	不适用	0.00		
高建		境内自然人	0.84%	3,683,005.00	0.00	不适用	0.00		
深圳华业天成投资有限公司—湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）		其他	0.70%	3,054,481.00	0.00	不适用	0.00		
香港中央结算有限公司		境外法人	0.67%	2,934,651.00	0.00	不适用	0.00		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金		其他	0.63%	2,746,817.00	0.00	不适用	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明			刘先兵持有苏州博盈 16.24%的财产份额并担任执行事务合伙人，直接持有苏州博臻 0.71%的财产份额并担任执行事务合伙人；高建持有苏州博盈 19.21%的财产份额；除上述情况之外，未知上述股东相互之间是否存在关联关系或一致行动						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

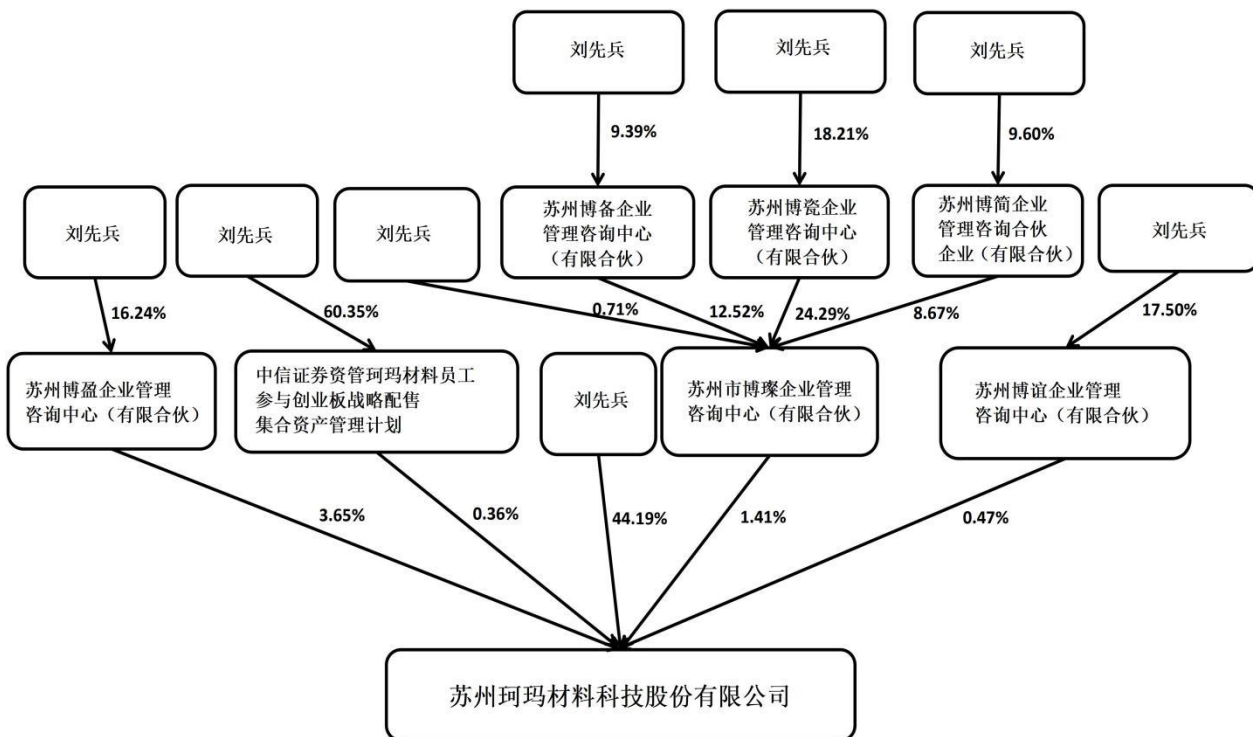
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无